

证券代码：688332

证券简称：中科蓝讯

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	2026年4月15日：永赢基金、中邮证券 2026年4月16日：线上参加公司2025年年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年4月15日至4月16日
地点	2026年4月15日：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司大会议室 2026年4月16日：价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	出席公司2025年年度业绩说明会： 董事长：黄志强 董事兼总经理：刘助展 副总经理兼董事会秘书：张仕兵 财务总监：李斌 独立董事：张潇颖 接待机构调研： 董事会办公室主任：曹卉 证券事务代表：刘懿瑶
投资者关系活动主要内容介绍	公司简介： 中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，目前已形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线

麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT 芯片、AI 语音识别芯片、Wi-Fi 芯片、视频芯片十大产品线为主的产品架构。同时产品已进入小米、realme 真我、荣耀亲选、万魔、飞利浦、倍思、漫步者、Anker、铁三角、传音、魅蓝、FIIL、弱水时砂、索爱、IKF、sanag、boAt、Noise、TITAN、NOKIA、腾讯 QQ 音乐、百度、喜马拉雅、博雅 BOYA 等终端品牌供应体系。

2025 年度，公司实现营业收入 18.42 亿元，同比增加 1.42%；利润总额 15.47 亿元，同比增加 398.33%；归属于母公司所有者的净利润 14.15 亿元，同比增加 371.66%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2.33 亿元，同比下降 4.49%。

问答环节：

1、端侧 AI 研发路线与商业化落地节奏是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！随着人工智能技术的快速发展，AI 耳机作为智能音频设备的重要分支，为用户提供了更加智能化、个性化的音频体验。2025 年，公司继续在 AI 产品中发力，配合火山引擎量产了 BT8951H 芯片，并搭载于机乐堂 JOYROOM OC3 AI 耳机，成为公司继 FIIL GS Links AI 高音质开放式耳机后第二款接入豆包大模型的耳机，AI 体验进一步提升；此外，公司 BT893X 芯片被搭载于 Nothing CMF Buds 2a TWS 耳机中，耳机集成 ChatGPT 语音交互，支持 42dB 主动降噪，双设备链接，总续航可达 35.5 小时。公司芯片面向市场通用产品，可配合客户适配国内外市场中的主流 AI 云端平台，让耳机全面 AI 化。除耳机产品外，报告期内，公司积极拓展 AI 玩具、AI 眼镜、AI 音箱等新的 AI 产品形态，除原有的蓝牙方案外，更增加了 Wi-Fi 方案，使 AI 产品的数据交互更流畅，适用性更广，相关产品将在 2026 年陆续量产。同时，公司投入了讯龙四代产品研发，CPU 多核+DSP 多核+NPU 的架构，为后续 AI 产品提供更大的算力保障。未来，公司将持续布局 AI 端侧领域，

继续与国内外大模型平台开展合作，向市场推出用户体验度更好的 AI 端侧产品解决方案。感谢您的关注。

2、在 AI 盛行的当下，请问公司后续是否会在算力方向做切入？

答：尊敬的投资者，您好！在 AI 算力部署方面，公司主要聚焦于端侧应用。考虑到此类设备对算力的需求不高，公司在 SoC 架构层面进行了针对性的规格演进与技术补充。首先，通过持续优化并提升硬件寄存器及存储器的规格，满足基础算力支撑；其次，针对高阶 AI 应用场景，在架构中引入了高性能 DSP。2026 年，公司即将推出面向高端耳机与音箱市场的旗舰级芯片。该产品集成 HiFi 5 DSP 内核，可提供更卓越的计算密度与处理效能，增强芯片在环境降噪、空间音频及语音交互等 AI 应用场景中的表现。感谢您的关注。

3、公司产品已导入多个手机品牌项目，请问当前品牌客户的合作进展如何？2026 年在品牌客户拓展方面有哪些目标，是否有新的头部客户突破计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司借助于 BT 系列芯片前期积累的口碑，更多的耳机、专业音频品牌客户与公司达成了长期深度的合作模式，2025 上半年推出的 OnePlus Bullets Wireless Z3，realme T200，Nothing CMF Buds 2a，荣耀亲选耳机 GEG X7e 等均搭载了公司 BT893X 系列芯片；近期上市发售的机乐堂 OC3 AI 耳夹式蓝牙耳机，搭载了公司 BT8951H 芯片，该产品已接入豆包大模型，支持 AI 智能问答，四麦通话降噪，并获得了 QQ 音乐臻品认证。同时，2025 上半年，公司推出多款新品，借助于极高的性能表现，获得国内外客户青睐：BT897X 系列芯片，支持浮点运算，基础功耗优化到 4mA 级别，音频指标也提升到行业领先水平，同时，通过加入 NPU 单元，极大地提升了芯片对 AI 通话算法的运算能力，降低了通话时的功耗，目前已搭载于 FIIL Key Pro2 入耳式 Hybrid

ANC 蓝牙耳机、弱水时砂琉璃 MK2 真无线降噪蓝牙耳机、倍思 BS1 NC 半入耳主动降噪耳机、喜马拉雅×1MORE 万魔联名款睡眠耳机 Z30, 后续会配合更多行业先进客户的耳机项目; BT891X 系列芯片: 超低功耗、旗舰级音频指标, 适配品牌入门级产品, 已搭载于多款耳机、无线麦克风产品中, 后续将有更多新品逐步推出; AB573X 系列芯片: 为 AB563X 芯片的升级版, 低功耗、旗舰级音频指标, 抗干扰效果好, 性价比高, 亦受到品牌客户青睐, 目前已搭载于漫步者 X Clip AI 耳夹式蓝牙耳机、索爱 JING 1 真无线蓝牙耳机。2025 年, 公司正式开启“两个连接”新篇章, 公司 Wi-Fi 技术成功落地, 推出集 Wi-Fi+ 蓝牙+音频三合一的高性能的 AB6003G 芯片, 并在 2025 火山引擎 FORCE 原动力大会以及由百度智能云、汕头市澄海区人民政府主办的 2025 AI 玩具产业创新和发展会议进行了展出。公司作为国内领先的智能音频芯片及 AIoT 解决方案提供商, 正以自主研发的 AB6003G Wi-Fi 芯片为核心, 积极布局 AI 玩具产业生态, 推动传统玩具向智能化、个性化、交互化方向升级。随着公司芯片产品的不断丰富, 可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求, 有助于公司不断提升市场竞争力和持续经营能力, 有望在更多的终端品牌客户中获得运用。感谢您的关注。

4、从去年起, 存储芯片价格开始加速上涨, 公司在是否采取了锁价措施, 存储价格上涨对公司的成本有多大影响?

答: 尊敬的投资者, 您好! 自去年下半年起, AI 端存储率先开始涨价, 公司已对存储价格走势做出大致判断, 并采取了相应准备措施: 适当加大了库存储备, 通过库存平摊; 加强了对上游供应商的管控, 并引入新供应商, 借助不同供应商进行价格平衡; 大容量存储的涨价幅度相对较高, 公司已经通过提高芯片售价实现成本转嫁。因此, 存储涨价对公司成本的整体影响相对温和, 整体幅度处于可控范围。感谢您的关注。

5、请问公司推出视频芯片了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司的 AB579X 单芯片视频方案，已经应用在无线对讲机（摄像头+屏幕显示），儿童照相机（摄像头+屏幕显示）等领域，同时也扩展了单芯片的入门智能眼镜市场，推动智能眼镜的普及度。公司还推出了蓝牙+音视频的 BT879X 系列芯片，高性能、高算力、内置高速 PSRAM 以扩展内存，自研高效 2.5DGPU、30W/100W 摄像头输入以及视频编解码，同时支持 LVGL9GUI 和自研 GUI。公司将持续深耕视频应用领域，相关新芯片会在 2026 年陆续推出，适配不同市场应用的需求。感谢您的关注。

6、公司对外战略投资逻辑是什么？是否会继续布局产业链？

答：尊敬的投资者，您好！公司围绕半导体核心领域进行战略布局，旨在助力公司实现长期稳健发展。公司紧密跟踪行业发展趋势，依托严谨的行业研判与投资筛选体系，重点聚焦 GPU、先进封装测试等高成长性、高技术壁垒领域，开展前瞻性、专业化投资布局。公司通过直接持股与间接投资相结合的方式，已对摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、上海燧原科技股份有限公司、江苏芯德半导体科技股份有限公司等行业优质企业进行投资，并通过和中芯聚源等专业机构合作的方式，持续在 GPU、先进封装测试等关键环节的产业布局，进一步夯实了公司在半导体领域的战略基础。感谢您的关注。

7、请问在高分红背景下，公司如何平衡股东回报与主业研发投入、产能扩张、新业务布局等资金需求？未来 3 年的分红政策是否会保持稳定性？

答：尊敬的投资者，您好！公司始终秉持稳健可持续的分红理念，兼顾现金分红的连续性与稳定性，坚持以投资者利益为核心，严格遵循相关法律法规及利润分配政策要求，并结合公司《未来三

年股东分红回报规划（2025年-2027年）》，综合考量行业特性、经营模式、发展阶段及盈利水平等因素，制定合理持续的利润分配方案。自2022年上市以来，公司已实施四次利润分配，最近三个会计年度累计现金分红达46,110.17万元，占同期年均净利润比例为70.32%，充分彰显了公司持续稳定回报股东的决心。公司留存未分配利润将滚存用于研发投入、人才建设及日常经营发展等资金需求。未来，公司将继续按照法律法规及《公司章程》相关规定，结合自身发展阶段、经营状况及现金流情况，统筹平衡主业研发、新业务布局与股东回报之间的资金需求，在保障公司持续健康发展的前提下，为股东创造长期稳定的投资回报。感谢您的关注。

8、高端耳机芯片客户导入、订单及毛利率情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司借助于BT系列芯片前期积累的口碑，更多的耳机、专业音频品牌客户与公司达成了长期深度的合作模式，2025上半年推出的OnePlus Bullets Wireless Z3，realme T200，Nothing CMF Buds 2a，荣耀亲选耳机GEG X7e等均搭载了公司BT893X系列芯片；近期上市发售的机乐堂OC3 AI耳夹式蓝牙耳机，搭载了公司BT8951H芯片，该产品已接入豆包大模型，支持AI智能问答，四麦通话降噪，并获得了QQ音乐臻品认证。同时，2025上半年，公司推出多款新品，借助于极高的性能表现，获得国内外客户青睐：BT897X系列芯片，支持浮点运算，基础功耗优化到4mA级别，音频指标也提升到行业领先水平，同时，通过加入NPU单元，极大地提升了芯片对AI通话算法的运算能力，降低了通话时的功耗，目前已搭载于FIIL Key Pro2入耳式Hybrid ANC蓝牙耳机、弱水时砂琉璃MK2真无线降噪蓝牙耳机、倍思BS1 NC半入耳主动降噪耳机、喜马拉雅×1MORE万魔联名款睡眠耳机Z30，后续会配合更多行业先进客户的耳机项目；BT891X系列芯片：超低功耗、旗舰级音频指标，适配品牌入门级产品，已搭载于多款耳机、无线麦克风产品中，后续将有更多新品逐步推出。公司BT系

列芯片毛利率约为 30%-40%。随着公司芯片产品的不断丰富，可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求，有助于公司不断提升市场竞争力和持续经营能力，有望在更多的终端品牌客户中获得运用。感谢您的关注！

9、蓝牙音箱芯片收入下滑，是需求还是竞争原因？后续如何恢复增长？

答：尊敬的投资者，您好！2025 年，在关税政策调整、地缘冲突持续、供应链区域化重组及存储芯片大幅涨价的多重因素叠加下，全球消费电子市场较为动荡。面对市场变化，公司积极推进产品升级，已推出基于 BT896X 的 LE Audio 解决方案，特别是 Auracast 技术，可满足中高阶音箱市场需求，并已在飞利浦等品牌的高端 Soundbar 产品中实现量产。依托 BT896X 的强大算力，公司完成高阶 Soundbar 蓝牙 SoC 单芯片方案落地。依托技术积累，公司于 2025 年推出了 BT880X、AB580X 系列中阶蓝牙音箱方案，全面支持 LE Audio/Auracast 技术，相关项目正稳步导入中。此外，公司还将基于新一代 Wi-Fi 芯片，陆续推出 Wi-Fi 智能音箱等产品解决方案，持续拓宽产品矩阵。感谢您的关注。

10、后续是否会持续围绕半导体产业链上下游（如 AI 算法、车规芯片、晶圆制造）进行投资布局？

答：尊敬的投资者，您好！公司围绕半导体核心领域进行战略布局，旨在助力公司实现长期稳健发展。公司紧密跟踪行业发展趋势，依托严谨的行业研判与投资筛选体系，重点聚焦 GPU、先进封装测试等高成长性、高技术壁垒领域，开展前瞻性、专业化投资布局。公司通过直接持股与间接投资相结合的方式，已对摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、上海燧原科技股份有限公司、江苏芯德半导体科技股份有限公司等行业优质企业进行投资，并通过和中芯聚源等专业机构合作的

	<p>方式，持续在 GPU、先进封装测试等关键环节的产业布局，进一步夯实了公司在半导体领域的战略基础。感谢您的关注。</p> <p>11、2025 年推出的 BT897X、BT891X 等高端耳机芯片，目前客户导入进度、订单交付情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司 BT897X 系列芯片，目前已搭载于 FIIL Key Pro2 入耳式 Hybrid ANC 蓝牙耳机、弱水时砂琉璃 MK2 真无线降噪蓝牙耳机、倍思 BS1 NC 半入耳主动降噪耳机、喜马拉雅×IMORE 万魔联名款睡眠耳机 Z30，后续会配合更多行业先进客户的耳机项目；BT891X 系列芯片适配品牌入门级产品，已搭载于多款耳机、无线麦克风产品中，后续将有更多新品逐步推出。随着公司芯片产品的不断丰富，可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求，有望在更多的终端品牌客户中获得运用。感谢您的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 4 月 17 日</p>